



ПАСПОРТ

МИКРОСХЕМЫ ТИПА КИКТ682

соответствуют техническим условиям О.548.079 ТУ

1. Функциональное назначение: четырехканальный аналоговый переключатель, предназначенный для коммутации аналоговых сигналов постоянного и переменного тока в различных радиоэлектронных устройствах.

2. Основные электрические параметры приведены в табл. I.

Таблица I

Основные электрические параметры	Буквенное обозначение	Норма		Примечание
		КИКТ682А	КИКТ682Б	
		не более	не более	
Динамическое сопротивление при $U_{зс} =$ минус 15 В, Ом	$R_{д}$	150	150	
Ток утечки стока, нА	$I_{с\text{ ут}}$	50	50	Значения токов утечек указаны для предельно допустимых значений и напряжений между сто- ком и подложкой $U_{зс}$, истоком и подложкой $U_{ис}$, затвором и под- ложкой $U_{зп}$
Ток утечки истока, нА	$I_{и\text{ ут}}$	50	50	
Ток утечки затвора, нА	$I_{з\text{ ут}}$	50	50	

3. Содержание золота 0,009518 г.

4. Рекомендации по установке и монтажу микросхем

4.1. Микросхемы должны устанавливаться на печатную плату после формовки выводов. Радиус изгиба равен 0,4 мм, минимальное расстояние от корпуса до центра окружности изгиба равно 1 мм.

4.2. Установку микросхем на плату в аппаратуре производить с зазором от 0 до 0,7 мм с последующей припайкой и приклейкой клемм. При установке микросхем допускается использовать прокладки из электроизоляционного материала.

4.3. Духение выводов микросхем проводить методом погружения в расплавленный припой. Температура расплавленного припоя не более 250°C. Время погружения не более 2 с. Расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм. Интервал между погружениями не менее 5 мин.

4.4. Пайку микросхем к печатной плате производить припоем ПОССу-61-0,5 ГОСТ 1499-70 с применением флюса ФКСн по нормам НО.054.063.

4.5. Очистка от флюса проводится протиркой тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью (1:1) согласно приложению 2 в ОСТ II ПО.029.000.

4.6. При пайке микросхем одножальным паяльником:

- температура жала паяльника, °C, не более 265
- время касания каждого вывода, с., не более 3
- интервал между пайками соседних выводов, с., не менее 3
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1

Жало паяльника должно быть заземлено.

4.7. При пайке микросхем групповым паяльником:

- температура жала группового паяльника, °C, не более 265
- время воздействия (одновременно на половину или на все выводы), с., не более 2
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1
- интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мин, не менее 5

Жало группового паяльника должно быть заземлено.

4.8. При обращении с микросхемами (в процессе измерений, распайки и т.д.) все металлическое оборудование, а также инструменты должны быть заземлены. Критерием качества заземления является отсутствие высокочастотных наводок, возникающих при включении и выключении силовых установок.

4.9. При хранении, транспортировке и обращении все выводы микросхем должны быть замкнуты замкнутко.

4.10. Микросхемы в блоках аппаратуры должны быть защищены четырьмя слоями бесцветного лака УР 231 МРТУ 6-10-863-69 или 8-100 МРТУ 6-10-897-69.

Температура сушки лака не более +60°C. Покрытие микросхем лаком производится по ОСТ II.ПО.014.001.

5. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C от минус 45 до +85
- относительная влажность воздуха при температуре +25°C, %, не более 98
- вибрации в диапазоне частот от 1 до 600 Гц с ускорением, g, не более 10
- многократные удары с ускорением, g, не более 75
- линейные (центробежные) ускорения, g, не более 25

Предельно допустимые эксплуатационные параметры при температуре от минус 45 до +85°C приведены в табл.2.

Таблица 2

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Норма	
		K1KT682A	K1KT682B
		не более	не более
Напряжение между стоком и подложкой, В	U _{сп}	10	15
Напряжение между истоком и подложкой, В	U _{ип}	10	15
Напряжение между затвором и подложкой, В	U _{зп}	30	30
Постоянный коммутируемый ток, мА	I _{ком}	20	20
Мощность, рассеиваемая микросхемой при температуре окружающей среды до +85°C, мВт	P _{макс}	100	100

Примечание. Максимальный импульсный коммутируемый ток определяется исходя из максимальной мощности рассеивания и предельных электрических режимов.

6. Время гарантийной наработки 10 000 ч.

7. Срок хранения 6 лет.

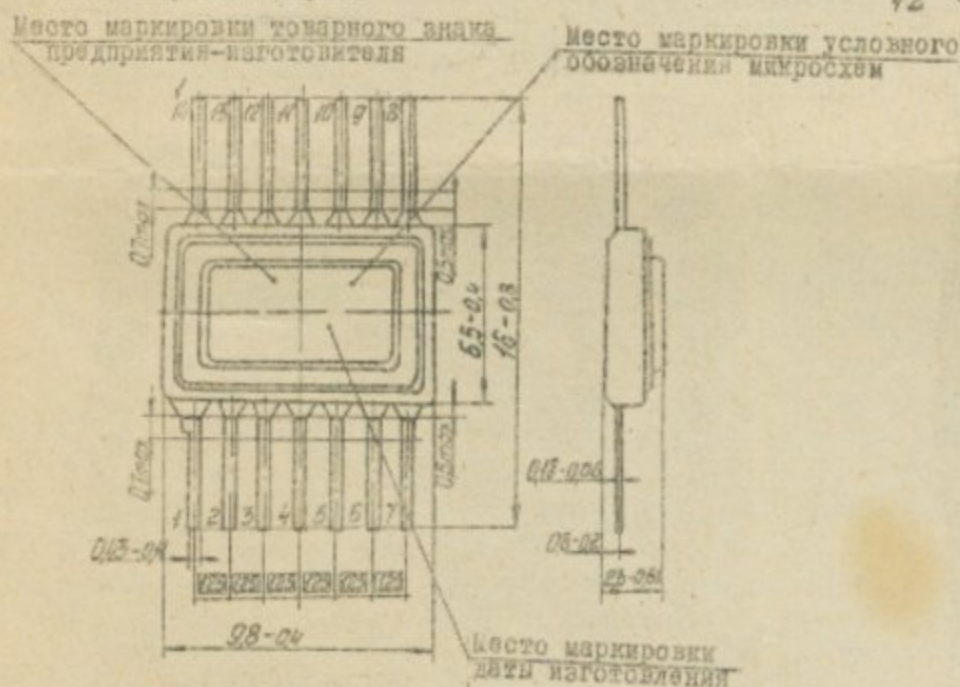
8. Гарантии предприятия-изготовителя:

- предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех поставляемых микросхем требованиям общих и частных технических условий и производит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим прейскурантам), если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют существующим требованиям общих и частных технических условий при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

9. Гарантии исчисляются со дня приема микросхем ОТК.

10. Расчерченный чертёж

12. Схема электрическая принципиальная.

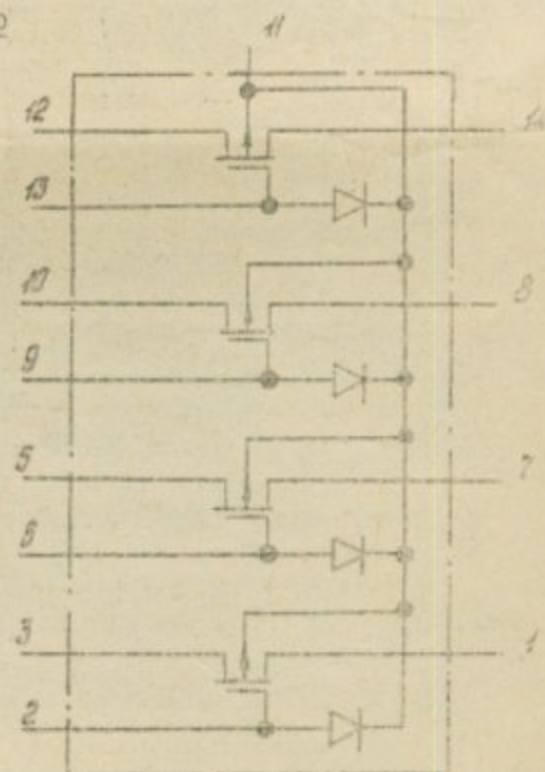


1. Симметрия плоскостей симметрии выводов от номинального расположения в зонах Г не более 0,05 (относительно выводов).

2. Нумерация выводов показана условно.

Корпус 401.14-1 шна 487.00773
шн 401.14-3 шна 487.00773

11. Масса не более 0,4 г.



3, 5, 10, 12 - аналоговые входы.

1, 7, 8, 14 - выходы.

2, 6, 9, 13 - управляющие входы

11 - подложка.

13. Дата выпуска

15 = 4 76

Штамп ОТК

